

2025年 6月 20日

委員各位殿

一般社団法人 溶接学会  
マイクロ接合研究委員会  
委員長 福本信次  
(公印省略)

## マイクロ接合研究委員会 開催通知

第150回マイクロ接合研究委員会を下記の通り開催致しますので、万障お繰り合せの上  
ご出席下さいますようお願い申し上げます。

**出欠は7月11日(金)までにお知らせ下さい**

### 記

1. 日 時 2025年 7月 18日(金) 10:30～16:30
2. 場 所 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913会議室  
東京都中央区日本橋本町二丁目3番11号 日本橋ライフサイエンスビルディング9階
3. 幹事会のご案内  
幹事会を12:00～開催いたしますので、幹事または代理の方はご出席下さいますよう  
お願い申し上げます。会場は911会議室です。

### 【出欠・事務関連の連絡先】

一般社団法人溶接学会 事務局 木暮  
E-mail: [s\\_kogure@tt.rim.or.jp](mailto:s_kogure@tt.rim.or.jp) TEL: 03-5825-4073

第150回マイクロ接合研究委員会  
プログラム

日 時: 2025年 7月 18日(金) 10:30~16:30

場 所: 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913 会議室(東京 日本橋)

時 間	題 目	講 演 者
司 会 中島 泰 (三菱電機)		
10:30~11:15	『アルミニウム合金を主軸とした分離可能な異材接合の基礎検討』 (資料番号MJ-882-2025)	大阪大学 ○小椋 智、清藤優成、 青木陽太郎
11:15~12:00	『積層複合ろう材を用いたアルミニウムとステンレス鋼のろう付技術』 (資料番号MJ-883-2025)	三菱電機(株) ○浅間晃司
12:00~13:00	昼 食 休 憩	
13:00~13:10	委 員 会 議 事	
司 会 西川 宏 (大阪大学)		
13:10~13:55	『異種金属接合体の易解体』 (資料番号MJ-884-2025)	群馬大学 ○半谷禎彦 大阪大学 森貞好昭、藤井英俊
13:55~14:40	『高圧粉末圧縮法による接合シート作製とその接合性評価』 (資料番号MJ-885-2025)	大阪大学 ○坂本一三、巽 裕章、 西川 宏
14:40~15:00	休 憩	
司 会 木下 慶人 (富士電機)		
15:00~15:45	『新規 Cu 系ろう材による異材接合技術の開発』 (資料番号MJ-886-2025)	(株)プロテリアル ○高野 俊、栗原祐也
15:45~16:30	『接合界面での反応拡散による金属間化合物の 成長とカーケンドルボイド生成に関する速度論的考察』 (資料番号MJ-887-2025)	(株)KOKUSAI ELECTRIC ○オ ミンホ 東京科学大学 小林郁夫

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

#### 4.配付資料について

当日の配布資料は委員会開催前にダウンロードシステムを利用し皆様へご送付致します。  
開催当日までにご自身にて印刷を行っていただきご準備のうえご参加をお願いいたします。

✓配付資料は各自でご持参ください。会場に紙資料のご用意はございません。

#### (案内図)



#### アクセス

- ・東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅A6出口より徒歩3分
- ・JR総武本線「新日本橋」駅 5番出口より徒歩2分
- ・JR各線「神田」駅 南口より徒歩 11 分
- ・JR各線「東京」駅 新日本橋口より徒歩 17 分